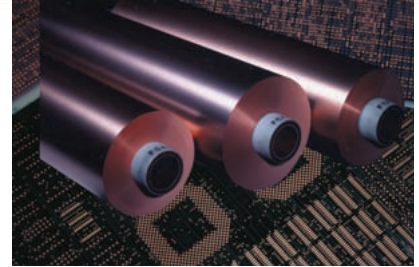


DT-GLD ビルドアップ用電解銅箔

●ビルドアップ用途の両面粗化処理電解銅箔は、古河電工の優れた表面粗化処理技術により開発され、すでに携帯電話基板などに採用されてIT機器の飛躍的な小型軽量化・高性能化に貢献し続けています。



箔種：DT-GLD箔 (12～35 μ m)

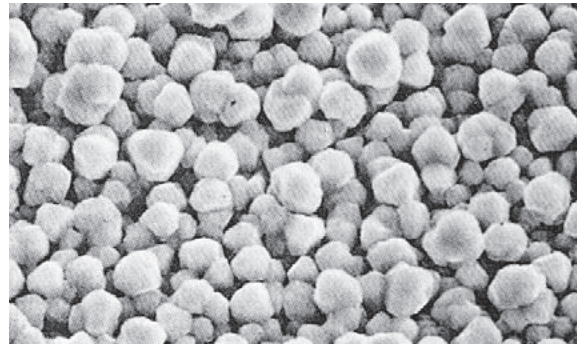
特長：・品質特性に定評のあるGTS処理を行った両面処理箔です。

- ・12～35 μ mまでの箔厚をラインナップしています。
- ・ビルドアップ基板に最適な両面粗化処理箔です。

粗面形状例



光沢面側



粗化処理面側

特性値例

試験項目	条件	単位	DT-GLD			
			STD		MP	
			12 μ m	18 μ m	35 μ m	
質量厚さ	—	g/m ²	135	170	305	
引張り強さ	常温	N/mm ²	340	330	300	
	180℃		170	170	170	
伸び率	常温	%	6	7	21	
	180℃		3	3	11	
表面粗さ (Rz)	粗化処理面	μ m	8.0	9.0	9.0	
	光沢面		5.5	5.5	5.5	
引きはがし強さ	FR-4	粗化処理面	kN/m	1.39	1.57	2.04
				光沢面	1.13	1.27
	ポリイミド	粗化処理面		1.29	1.52	—
		光沢面		1.08	1.23	—
耐湿劣化率 D-2/100	FR-4	粗化処理面	%	2.4	3.2	3.5
		光沢面		1.4	1.6	1.6
	ポリイミド	粗化処理面		1.8	2.1	—
		光沢面		1.3	1.3	—
耐ハローイング性 (18% HCL、30分)			良好	良好	良好	

古河電工

古河電気工業株式会社 <http://www.furukawa.co.jp/>

金属カンパニー 銅箔事業部 営業部

〒321-2336 栃木県日光市荻沢601-2 TEL. (0288) 22-3490 FAX. (0288) 22-3479